

BCL-SMT 3.81/02/90LFI 1.5AU BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Розеточный разъем с обратным расположением BCL-SMT для печатной платы имеет три существенных преимущества: BCL-SMT
• обеспечивает защиту от прикосновения на печатной плате и, таким образом, подходит для находящихся под напряжением выходов
• расширяет область применения за счет соединения узлов по типу плата-плата
• подходит для пайки по технологии reflow и пригоден для использования в случае автоматизированного процесса сборки и пайки

Два направления вывода проводов предоставляют свободу организации для различных вариантов расположения:
• 180° вертикально
• 90° горизонтально
Доступны 2 варианта корпуса BCL-SMT:
• без фланца
• с обратным фланцем под пайку ("LFI", с гайкой)
Крепление к печатной плате без дополнительного винтового соединения
• Крепление к SCZ FI с помощью винта
Соединительные разъемы компании Weidmüller с шагом 3,81 мм (0,15 дюйма) по компоновке совместимы со стандартными соединительными разъемами, снабжены местом для надписей, где может быть нанесена кодировка.

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, Фланец под пайку обратный, Соединение THT/THR под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина контактного штифта (l): 1.5 mm, позолоченный, черный, Ящик
Номер для заказа	1160610000
Тип	BCL-SMT 3.81/02/90LFI 1.5AU BK BX
GTIN (EAN)	4032248959709
Кол.	50 Шт.
Продуктное отношение	UL:
Упаковка	Ящик

BCL-SMT 3.81/02/90LFI 1.5AU BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	1,58 g
-------------	--------

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	495 мм
VPE с	355 мм	Высота VPE	182 мм

Системные характеристики

Серия изделия	OMNIMATE Signal — серия BC/SC 3.81			
Вид соединения	Соединение с платой			
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку			
Шаг в мм (P)	3,81 мм			
Шаг в дюймах (P)	0,15 inch			
Угол вывода	90°			
Количество полюсов	2			
Длина контактного штифта (l)	1,5 мм			
Допуск на длину выводов под пайку	0 / -0,02 mm			
Размеры выводов под пайку = допуск d+0,05 / -0,05 mm				
Наружный диаметр площадки под пайку	1,9 мм			
Диаметр отверстия трафарета	1,6 мм			
L1 в мм	3,81 мм			
L1 в дюймах	0,15 inch			
Количество полюсных рядов	1			
Объемное сопротивление	≤5 mΩ			
Усилие вставки на полюс, макс.	9,5 N			
Усилие вытягивания на полюс, макс.	6 N			
Момент затяжки	Тип момента затяжки	Крепежный винт, Печатная плата		
	Информация по использованию	Момент затяжки	мин.	0,1 Nm
			макс.	0,15 Nm
		Рекомендуемый винт	Номер детали	PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP GF	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Материал контакта	Медный сплав	Поверхность контакта	позолоченный
Структура слоев соединения под пайку	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn матовый	Структура слоев штепсельного контакта	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn / 1.7...2.3 μm Au
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	120 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	120 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984
---------------------------------	------------------------

BCL-SMT 3.81/02/90LFI 1.5AU BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Номинальные характеристики по CSA**

Номинальное напряжение (группа использования В/CSA)	300 V	Номинальное напряжение (группа использования С/CSA)	50 V
Номинальный ток (группа использования В/CSA)	11 A	Номинальный ток (группа использования С/CSA)	11 A

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus)		Сертификат № (cURus)	E60693
Ссылка на утвержденные значения	В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.		

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания	• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев

Сертификаты

Сертификаты	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E60693

Загрузки

Технические данные	STEP
--------------------	----------------------

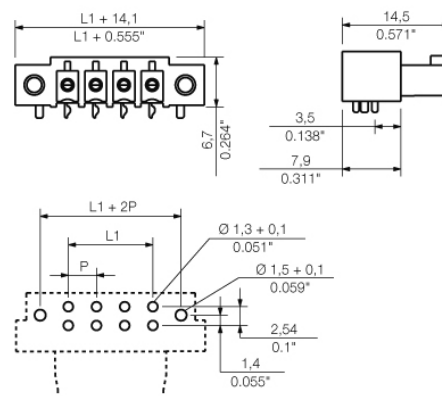
BCL-SMT 3.81/02/90LFI 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

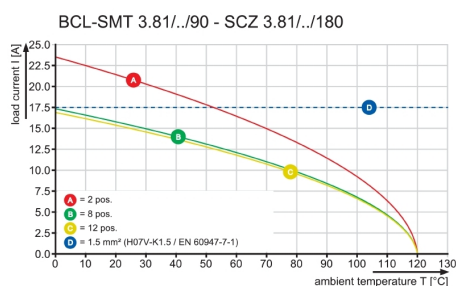
www.weidmueller.com

Изображения

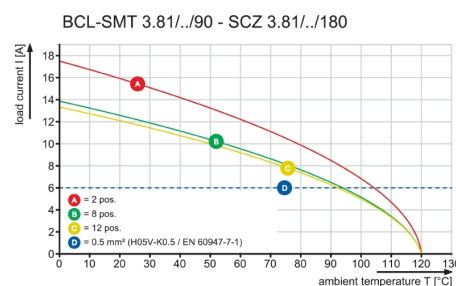
Dimensional drawing



Graph



Graph



Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.